

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

523

ML6

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

10.08.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	μm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	360		2
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3
B-RS-FR4-ML-0.93mm-035+035-TG150-HF	50200663	35	L2	4
		930		
		35	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	345		5
		0		6
B-RS-FR4-ML-0.93mm-035+035-TG150-HF	50200663	35	L4	7
		930		
		35	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	360		8
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		9
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	10

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 μm

Tol+:

320 μm

Tol-:

320 μm

Dmax:

3410 μm

Dmin:

2770 μm

Gesamtdicke über alles

0 μm

Tol+:

0 μm

Tol-:

0 μm

Dmax:

0 μm

Dmin:

0 μm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 μm

Tol+:

320 μm

Tol-:

320 μm

Dmax:

3520 μm

Dmin:

2880 μm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3101 μm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik